

宁波江丰电子材料股份有限公司

2025 年度财务决算报告

报告期内，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2026]第 ZF10345 号）。现将 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标及其变动情况

（一）主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,604,100,743.12 | 3,604,962,847.84 | 27.72% | 2,601,608,568.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 499,503,040.66 | 400,564,027.03 | 24.70% | 255,474,568.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 360,394,848.27 | 303,505,740.66 | 18.74% | 155,706,191.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 470,016,208.29 | -96,329,842.68 | 587.92% | 251,025,634.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.89 | 1.51 | 25.17% | 0.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.89 | 1.51 | 25.17% | 0.96 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.58% | 9.24% | 1.34% | 6.25% |
| | 2025 年末 | 2024 年末 | 本年末比上年末增减 | 2023 年末 |
| 资产总额（元） | 10,582,798,046.07 | 8,689,443,785.51 | 21.79% | 6,271,647,079.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,968,925,631.42 | 4,501,834,620.36 | 10.38% | 4,174,314,633.25 |

二、公司主营业务及其经营状况的分析

（一）主营业务

公司主要专注于超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件的研发、生产和销售。其中超高纯金属溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属合金靶材等，这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、液晶面板制造的物理气相沉积（PVD）工艺以制备电子薄膜材料。半导体精密零部件包括金属、陶瓷、树脂等多种材料经复杂工艺加工而成的精密

零部件，主要用于半导体芯片以及平板显示器生产线的机台，覆盖了包括 PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产业机器人等应用领域，其生产过程对于材料精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高，产品主要出售给晶圆制造商作为设备使用耗材或出售给设备制造商用于设备生产。

（二）主要产品

1、超高纯金属溅射靶材

公司主要生产超高纯金属溅射靶材，包括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材及铜合金靶、钨钛靶、镍靶和钨靶等。

（1）超高纯铝靶材

超高纯铝及其合金是目前使用最为广泛的半导体芯片配线薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9995%（5N5）以上，平板显示器用铝靶的金属纯度略低，一般要求达到 99.999%（5N）以上。目前，公司生产的铝靶已经广泛应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器制造等领域。

（2）超高纯钛靶材及环件

在超大规模集成电路芯片中，超高纯钛是最为常用的阻挡层薄膜材料之一（相应的导电层薄膜材料为铝）。钛靶材及环件主要应用于 130-5nm 工艺当中，钛靶材及环件配套使用，其主要功能是辅助钛靶完成溅射过程，以实现更好的薄膜性能并达到更高的集成度要求。目前，公司生产的钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域。

（3）超高纯钽靶材及环件

在先端的铜制程超大规模集成电路芯片中，超高纯钽是阻挡层薄膜材料。钽靶材及环件是在 90-3nm 的先进制程中必需的阻挡层薄膜材料，主要应用在最尖端的芯片制造工艺当中。因此，钽靶材及环件是靶材制造技术难度最高、品质一致性要求最高的尖端产品，在此之前仅有少数几家跨国公司能够生产。特别是钽环件生产技术要求极高，目前只有公司及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，钽靶材及环件的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。目前，公司生产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路芯片制造领域。

（4）超高纯铜靶材及铜合金靶

超高纯铜靶材及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电层薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9999%（6N）以上，平板显示器用铜靶的金属纯度略低，要求达到 99.999%

(5N)。铜及铜合金作为导电层通常用于 90-3nm 技术节点的先端芯片中。特别是铜锰合金靶材制造难度高，目前只有公司及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，铜锰合金靶材的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。公司生产的铜及铜合金靶材主要用于超大规模集成电路芯片、平板显示器制造领域。

(5) 超高纯钨靶材

超高纯钨靶主要应用在 IC 集成电路存储芯片中，是存储芯片的“金属骨架”，在 3D NAND 工艺中作为薄膜种子层。半导体级超高纯钨及合金靶纯度需达到 5N 以上(99.9999%)，关键特定有害杂质（如 Na/K 等）需控制在千万分之一以下水平。近年来存储芯片市场由人工智能（AI）和高带宽内存（HBM）技术重塑，导致超高纯钨靶的市场需求激增，全球供应链极其紧张。目前只有公司及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术，近年来公司生产的超高纯钨靶已在多家国际知名存储芯片制造商实现批量应用。

2、半导体精密零部件

超大规模集成电路芯片 PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备由各种精密零部件结合构成，这些部件主要包括传输腔体、反应腔体、膛体、圆环类组件（Ring）、腔体遮蔽件（Shield）、保护盘体（Disc）、冷却盘体（Cooling Arm）、加热盘体（Heater）、气体分配盘（Shower Head）、气体缓冲盘（Block Plate）等；材料包括金属类（不锈钢、铝合金、钛合金）、非金属类（陶瓷、石英、硅、高分子材料）等；制造工艺包括超精密加工、扩散焊、氩弧焊、真空钎焊、表面处理、阳极氧化、等离子喷涂、热喷涂、特殊涂层、超级净化清洗等。在芯片先进制程生产工艺中，各种精密零部件作为耗材被广泛使用，零部件产品对精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高。目前，公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片制造领域。

(三) 主要经营模式

1、采购模式

公司依据销售订单和生产计划制定具体的采购计划，结合主要原材料的现有库存量、采购周期、在途时间等因素计算具体的采购数量，并确保一定的安全库存量。对于主要原材料的采购，公司已经建立了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商结成了长期稳定的战略合作伙伴关系，根据制定的采购计划实施采购；对于其他原材料的采购，公司通常会选择 2-3 家合格供应商（单一供应商除外），建立多家供货渠道，经询价后确定供应商并及时采购入库。

2、生产及研发模式

由于公司的终端用户多为世界一流芯片制造企业,各客户拥有独特的技术特点和严苛的品质要求,为此公司根据客户的个性化需求采取了定制化的生产模式。研发生产的产品在材料、成分、形状、尺寸、性能参数等诸多方面存在着不同,公司生产具有“多品种、小批量”的特点。在产品研发及设计前期,公司要投入大量精力与终端客户进行技术、品质、性能的交流,当产品通过客户评价后,生产部门在接到来自销售部门的客户订单后,即根据订单制定生产计划,实行“以销定产”的生产模式。

公司已经掌握了超高纯金属溅射靶材生产中的核心技术,形成了晶粒晶向控制、材料焊接、精密加工、产品检测、清洗包装等在内的完整业务流程,通过合理调配机器设备和生产资源自主组织生产,实行柔性化生产管理。在半导体先进制程领域,公司持续紧跟下游客户不同的技术路线演变需求和变革需求,从而实现先进制程领域超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产。同时,公司将在半导体用超高纯金属溅射靶材领域长期积累的技术研发、品质保障、客户服务等能力成功应用到半导体精密零部件领域,迅速拓展了精密零部件产品线。

3、销售模式

由于超大规模集成电路产业对溅射靶材和零部件的产品质量、性能指标等有着较为严苛的要求,因此,公司下游客户存在严格的供应商和产品认证机制。公司与潜在客户初步接触之后,需要经过供应商初评、产品报价、样品检测、小批量试用、稳定性检测等认证程序之后,才能成为合格供应商并批量供货。

公司与客户的销售模式包括直销和商社代理销售模式。直销模式下,公司及公司的具体产品通过了客户认证评价后,由客户向公司下达月度或季度订单,公司按约定的交货期向客户发货。商社代理模式则是指公司的日本终端客户通过三菱化学旗下的综合商社等知名商社向公司采购产品的模式。该模式在日本制造业企业中较为普遍,其业务流程为最终客户首先与综合商社签订采购合同,综合商社再与公司签订合同,公司按照合同要求发货至综合商社指定仓库,由综合商社向公司支付货款。公司全资子公司日本江丰成立后,公司日本终端客户也可以通过日本江丰直接向公司采购。

公司当前的经营模式是基于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件产品原材料供应情况、生产工艺、公司所处行业市场竞争格局确定的,报告期内未发生重大变化。报告期内,公司的主营业务一直专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的研发、生产和销售,预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

(四) 主要的业绩驱动因素

1、集成电路行业发展前景良好

随着人工智能、5G 通信、物联网、云计算、汽车电子、机器人和无人机等应用领域市场的持续成长，全球集成电路产业市场景气度高涨。根据 WSTS 数据，2023-2024 年，全球半导体行业规模分别约 5,269 亿美元、6,269 亿美元，2025 年预计达到 6,972 亿美元。其中，中国集成电路产业受益于巨大的市场需求、稳定的经济增长及有利的产业政策引导等因素，市场规模增速全球领先。根据国家统计局数据，中国集成电路产量由 2015 年的 1,087.10 亿块增长至 2024 年的 4,514.23 亿块，年均复合增长率超 17%。

随着芯片技术的创新突破及迭代升级，以及终端应用领域的持续和多元化发展，市场对于芯片的需求愈发强劲。这种强劲的消费需求成为驱动晶圆制造商扩大产能的重要动力。近年来，全球晶圆制造商纷纷投资建设新的产能，同时国内晶圆制造商也充分布局产能扩张，进而带动了整个半导体产业的发展，也带动了溅射靶材和半导体精密零部件市场的持续扩容。全球集成电路产业的持续向好发展，为公司业绩的增长提供了强有力的正向驱动力。

2、超高纯金属溅射靶材市场需求持续上升

随着芯片向先进制程的演进，市场对靶材的纯度和工艺精度提出了更为严苛的要求，人工智能（AI）、5G 通信、物联网（IoT）等前沿技术的迅速普及和广泛应用，催生了芯片需求的持续大幅增长，也带动了溅射靶材终端应用领域的进一步扩大，全球溅射靶材市场规模稳定增长。

公司在半导体用超高纯金属溅射靶材领域拥有深厚的技术积淀、丰富的生产经验以及稳固的客户基础，已经形成显著的竞争优势。公司把握国内外市场发展的有利机遇，积极进行多品类产品的战略布局，充分满足客户多样化、定制化的需求。通过持续的技术创新和市场拓展，公司在全球超高纯金属溅射靶材市场的占有率不断提升，为未来的持续发展奠定了坚实的基础。

3、半导体精密零部件产品加速放量

半导体精密零部件业务主要有两大需求来源：（1）晶圆制造商现有设备的零部件定期更换需求；（2）晶圆制造商新购设备生产中零部件的增量需求。得益于国内芯片制造业蓬勃发展，供应链国产化趋势逐渐加强，公司抢占市场先机，加大自主创新和研发力度，将在靶材领域长期积累的技术研发、品质保障、客户服务等能力成功应用到半导体精密零部件领域，推动产品线迅速拓展，新品加速放量，实现了多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用。

（五）报告期主要经营情况

2025 年，公司坚持科技创新，持续加大研发投入，提升新产品、新技术的研发能力，强化先端制程产品竞争力，密切跟踪客户需求，努力扩大全球市场份额。

报告期内，公司实现营业收入人民币 46.04 亿元，同比增长 27.72%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4.995 亿元，同比增长 24.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币 3.60 亿元，同比增长 18.74%。公司完成的主要工作如下：

1、扎根超高纯金属溅射靶材领域，注入强劲持续发展动能

公司锚定国际最前沿的集成电路技术，致力于在持续推动超高纯金属溅射靶材自主可控的同时，努力成为一家能够“走出去”且具备国际竞争力的全球领先企业，不断缩小与全球头部企业的差距，持续提升市场份额与品牌影响力。公司洞悉行业发展趋势，以市场需求为导向，用心做好产品、服务好客户，满足全球客户的多样化需求，多次荣获客户端最佳供应商、A 级供应商等荣誉，成为客户最喜爱的公司。报告期内，客户订单持续攀升，超高纯金属溅射靶材实现销售收入人民币 28.50 亿元，同比增长 22.13%，公司在全球晶圆制造溅射靶材领域的市场份额进一步扩大，在技术上和市场份额方面均跻身全球领先行列，成功将过去依赖进口的“卡脖子”短板转化为参与国际竞争的优势产业。

报告期内，公司还加速推进全球化战略布局，打造开放、包容与多元化的人才团队，为扩大全球市场份额夯基垒台；此外，公司充分发挥龙头企业的牵引作用，着力培育优质原材料供应商，已经实现原材料采购的国内化、产业链的本土化，构建了安全稳定的供应链体系，进一步拓宽产业护城河。

2、完善半导体精密零部件业务布局，着力打造第二成长曲线

公司积极拓展半导体精密零部件业务，现已成为国内多家知名半导体设备公司和国际一流芯片制造企业的核心零部件供应商。公司与装备、晶圆制造企业不断加强合作，突破先进工艺技术，实现了关键核心零部件的批量化生产。公司建设零部件专线工厂，引育团队，聚焦核心难题，建立独立的研发、技术支持、制造体系，加快突破速度。随着产能建设突破瓶颈，半导体精密零部件产品线迅速拓展，真空阀、加热器等核心产品实现技术突破，相关产品逐步从试制阶段推进到批量生产，新品销售持续放量。公司零部件产品已经在物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、刻蚀（Etch）、离子注入、光刻、氧化扩散等半导体核心工艺环节得到广泛应用，可量产气体分配盘（Shower head）、Si 电极等 4 万多种零部件，形成了全品类零部件覆盖。

报告期内，半导体精密零部件业务已成为公司第二大业务板块，销售业绩稳步增长，实现销售收入人民币 10.84 亿元，同比增长 22.24%。

3、强化自主研发与科技创新能力，持续提升核心竞争力

公司坚持以技术创新为立身之本，不断加大研发投入，充分发挥自主创新优势，着力培养本领域的科创人才，形成技术实力雄厚、梯队完整的国际一流超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件研发、生产、管理团队。报告期内，公司研发费用达人民币 2.62 亿元，同比增长 20.60%。公司持续攻坚靶材关键技术，牢牢掌握下游应用芯片朝先进制程演进的大势，公司生产的超高纯金属溅射靶材已批量应用于全球知名半导体芯片制造商先端技术节点的芯片制造。此外，公司生产的先端存储芯片用高纯 300mm 硅靶实现稳定批量供货，晶圆薄膜沉积工艺用精密温控核心部件出货量逐步攀升。公司还攻克了半导体精密零部件及新材料的多项核心技术，创新成果的不断涌现为公司培育和发展新质生产力提供了有力支撑。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司共取得国内有效授权专利 1034 项，包括发明专利 576 项，实用新型专利 453 项，外观设计专利 5 项。另外，公司还取得韩国发明专利 6 项、中国台湾地区发明专利 1 项、日本发明专利 2 项、新加坡发明专利 4 项。

此外，公司凭借“‘双确认五验证’高可靠质量控制技术创新管理模式”成功入选国家工信部 2024 年度质量提升与品牌建设典型案例名单；公司凭借“液晶显示用高性能加硬铜靶材”项目被中国光学光电子行业协会、中国电子材料行业协会与电子化工新材料产业联盟联合授予“2024 年度新型显示产业链特殊贡献项目”荣誉；公司凭借在半导体核心材料领域的技术突破、自主知识产权积淀与全产业链支撑能力，成为第一批入选中国芯支撑服务奖的材料企业，并获得中国电子信息产业发展研究院颁发的“优秀支撑服务企业”奖。同时，公司蝉联 2025 宁波市竞争力企业百强第 1 位，并列 2025 宁波市制造业企业百强第 59 位。

4、推动数字化转型和智能制造，构建新型生产体系

报告期内，公司全面推进数字化转型，在完成产品全价值链信息系统建设的基础上，引入高效、智能的企业数字化技术平台，通过统一数据治理体系和数字化技术中台打通全价值链信息系统的数据壁垒，从而实现研发、生产、供应链、营销等环节数据的实时流转与深度融合，推动公司从“信息系统覆盖”迈向“数据驱动运营”，显著提升价值链协同效率、资源配置精度与市场响应速度。

此外，公司有序推进黄湖智能工厂建设，智能化立体仓储、柔性自动化单元线、数字化生命周期系统集成等核心模块已进入单体测试阶段，即将开展全线联调联试，形成高效联动的智能生产网络，实现生产效率跃升、人力成本优化、订单响应提速与库存周转效率提升，推动公司运营模式从“数据驱动”向“智能引领”升级，构建柔性化、智能化、高效化的新型生产体系，为公司在行业竞争中抢占先机、实现长远发展奠定坚实的基础。

5、有效提升公司治理水平和信披质量，切实保障投资者权益

公司持续完善公司治理，切实提高公司治理水平和信息披露质量，积极回报投资者，主动履行社会责任，通过多项举措推动公司高质量发展和价值提升。公司在深圳证券交易所创业板上市公司 2024-2025 年度信息披露考核中再次获得最高等级 A 级，凭借投资者关系管理的积极表现，公司再次成功入选“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

报告期内，公司持续完善《公司章程》中“利润分配”等相关条款，并制定《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》，保持利润分配政策的连续性和稳定性，建立了持续、科学的投资者回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

6、启动向特定对象发行股票项目，加速全球化战略布局

公司凭借持续的技术深耕与创新突破，已逐渐成长为国内超高纯金属溅射靶材产业的领先者，具备与同行跨国公司竞争的实力。目前超高纯金属溅射靶材的国产化率仍有待进一步提升，公司需加速投建产能，以满足持续增长的市场需求并推动该领域国产自主可控水平进一步提升；此外，在半导体产业链自主可控的行业发展趋势下，高端半导体精密零部件国产化率水平亟需进一步提升。在上述背景下，公司启动向特定对象发行股票项目，于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《向特定对象发行股票预案》等事项，于 2026 年 3 月 18 日收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波江丰电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过。

公司计划通过本次发行在韩国建设半导体溅射靶材生产基地、实现关键零部件静电吸盘产业化、进一步建设升级研发检测中心以及区域性更强的综合性服务中心。本次向特定对象发行股票项目的实施将进一步优化公司产能布局、建设全球性先进制造工厂，夯实公司核心技术护城河，增强客户服务能力，提升公司的国际化竞争力和全球市场份额；同时，也有利于公司进一步加大关键零部件的投入，持续完善半导体精密零部件业务布局，为国家半导体零部件产业的自主可控提供重要支撑。

（六）营业收入情况

1、报告期营业务收入情况

单位：人民币元

| | 2025 年 | | 2024 年 | | 同比增减 金额 |
|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 金额 | 占营业收入比 重 | 金额 | 占营业收入比 重 | |
| 营业收入合计 | 4,604,100,743.12 | 100% | 3,604,962,847.84 | 营业收入合计 | 4,604,100,743.12 |

| 分行业 | | | | | |
|------------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4,604,100,743.12 | 100.00% | 3,604,962,847.84 | 100.00% | 27.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 超高纯靶材 | 2,849,932,588.99 | 61.90% | 2,333,453,280.70 | 64.73% | 22.13% |
| 精密零部件 | 1,083,878,534.39 | 23.54% | 886,702,340.41 | 24.60% | 22.24% |
| 其他 | 670,289,619.74 | 14.56% | 384,807,226.73 | 10.67% | 74.19% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 3,035,622,802.98 | 65.93% | 2,159,508,496.94 | 59.90% | 40.57% |
| 外销 | 1,568,477,940.14 | 34.07% | 1,445,454,350.90 | 40.10% | 8.51% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 4,491,998,887.31 | 97.57% | 3,506,882,072.44 | 97.28% | 28.09% |
| 代理 | 112,101,855.81 | 2.43% | 98,080,775.40 | 2.72% | 14.30% |

2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4,604,100,743.12 | 3,353,091,961.60 | 27.17% | 27.72% | 29.50% | -1.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 超高纯靶材 | 2,849,932,588.99 | 1,874,059,301.94 | 34.24% | 22.13% | 16.99% | 2.89% |
| 精密零部件 | 1,083,878,534.39 | 922,564,979.17 | 14.88% | 22.24% | 37.38% | -9.39% |
| 其他 | 670,289,619.74 | 556,467,680.49 | 16.98% | 74.19% | 76.18% | -0.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 3,035,622,802.98 | 2,285,372,765.61 | 24.71% | 40.57% | 45.91% | -2.76% |
| 外销 | 1,568,477,940.14 | 1,067,719,195.99 | 31.93% | 8.51% | 4.37% | 2.70% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 4,491,998,887.31 | 3,269,990,381.26 | 27.20% | 28.09% | 29.92% | -1.03% |
| 代理 | 112,101,855.81 | 83,101,580.34 | 25.87% | 14.30% | 14.98% | -0.44% |

三、公司资产、费用同比发生重大变动的说明

(一) 资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 2025 年末 | | 2025 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 金额 |
|----------|------------------|------------|------------------|------------|--------|---------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,310,648,401.23 | 12.38% | 1,155,079,340.99 | 13.29% | -0.91% | |
| 应收账款 | 1,244,501,022.18 | 11.76% | 1,005,134,213.89 | 11.57% | 0.19% | |
| 存货 | 1,541,378,284.97 | 14.56% | 1,450,613,954.01 | 16.69% | -2.13% | |
| 投资性房地产 | 104,761,293.05 | 0.99% | 110,458,179.53 | 1.27% | -0.28% | |
| 长期股权投资 | 453,090,677.58 | 4.28% | 427,156,556.79 | 4.92% | -0.64% | |
| 固定资产 | 2,879,985,419.22 | 27.21% | 1,299,858,918.27 | 14.96% | 12.25% | 主要系报告期内公司厂房、设备等转固所致。 |
| 在建工程 | 1,428,844,702.88 | 13.50% | 2,006,304,725.43 | 23.09% | -9.59% | 主要系报告期内公司自建厂房、设备等转固所致。 |
| 使用权资产 | 84,812,964.81 | 0.80% | 76,444,862.06 | 0.88% | -0.08% | |
| 短期借款 | 457,482,241.30 | 4.32% | 398,225,464.08 | 4.58% | -0.26% | |
| 合同负债 | 14,060,493.08 | 0.13% | 8,696,840.31 | 0.10% | 0.03% | |
| 长期借款 | 1,897,699,000.00 | 17.93% | 1,388,157,000.00 | 15.98% | 1.95% | 主要系报告期内公司根据资金需求增加中长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 47,773,692.86 | 0.45% | 43,207,865.43 | 0.50% | -0.05% | |
| 应收款项融资 | 94,112,331.76 | 0.89% | 16,751,425.49 | 0.19% | 0.70% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 38,431,990.09 | 0.36% | 21,296,632.07 | 0.25% | 0.11% | 主要系报告期内预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 48,685,242.39 | 0.46% | 10,394,539.97 | 0.12% | 0.34% | 主要系报告期末应收出口退税额增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 9,572,860.63 | 0.09% | 17,302,560.63 | 0.20% | -0.11% | 主要系报告期内公司转让“芯链融创”股权所致。 |
| 其他非流动资产 | 231,629,784.55 | 2.19% | 56,558,739.95 | 0.65% | 1.54% | 主要系预付长期资产购置款增加所致。 |
| 应付票据 | 447,670,478.00 | 4.23% | 48,004,726.50 | 0.55% | 3.68% | 主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 119,482,200.45 | 1.13% | 87,693,183.78 | 1.01% | 0.12% | 主要系公司人员增加，工资薪金增加所致。 |
| 应交税费 | 97,897,663.52 | 0.93% | 64,485,706.67 | 0.74% | 0.19% | 主要系报告期内应交增值税增加所致。 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------------|-------|-------|-----------------------|
| 其他应付款 | 65,729,630.76 | 0.62% | 20,400,386.85 | 0.23% | 0.39% | 主要系报告期内附转股权的借款增加所致。 |
| 递延收益 | 115,180,407.89 | 1.09% | 81,869,217.07 | 0.94% | 0.15% | 主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。 |

(二) 费用变化情况

单位：人民币元

| | 2025 年 | 2024 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 销售费用 | 132,290,264.06 | 114,619,252.32 | 15.42% | |
| 管理费用 | 315,032,094.34 | 273,312,933.86 | 15.26% | |
| 财务费用 | 81,464,110.65 | 15,129,416.30 | 438.45% | 主要系利息费用增加、汇兑损益变动所致。 |
| 研发费用 | 262,053,190.39 | 217,289,761.68 | 20.60% | |

四、 现金流量变动的说明

单位：人民币元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,945,722,751.49 | 3,308,985,128.79 | 19.24% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,475,706,543.20 | 3,405,314,971.47 | 2.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 470,016,208.29 | -96,329,842.68 | 587.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 112,348,278.64 | 131,315,379.79 | -14.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,318,968,567.35 | 1,481,231,597.64 | -10.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,206,620,288.71 | -1,349,916,217.85 | 10.62% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,673,539,047.68 | 2,190,586,637.62 | 22.05% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,039,900,138.00 | 583,366,118.60 | 249.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 633,638,909.68 | 1,607,220,519.02 | -60.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112,032,344.71 | 166,535,668.51 | -167.27% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2025 年度较上年同期增加 56,634.61 万元，增幅为 587.92%，主要系公司销售收入稳步增长，销售回款及现金流入增加，且公司积极运用票据结算方式，导致以票据支付的采购规模有所上升。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2025 年度较上年同期增加 14,329.59 万元，增幅为 10.62%，主要系报告期内公司积极运用票据结算方式，用于长期资产的现金支出相应减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2025 年度较上年同期减少 97,358.16 万元，降幅为 60.58%，主要系公司到期归还银行贷款增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额: 2025 年度较上年同期减少 27,856.80 万元, 降幅为 167.27%, 主要系公司到期归还银行贷款增加所致。

五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

(一) 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---------------------------------|--------------|------|
| 执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定 | 无 | 0.00 |

六、利润分配情况

以 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 265,320,683 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 1,020,200 股后的股本 264,300,483 股为基数, 每 10 股派发现金股利人民币 3.86 元(含税), 合计派发现金股利人民币 102,019,986.43 元(含税), 不送红股, 也不进行资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转至以后年度。

若 2026 年 1 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本及回购股份数量发生变动的, 则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份(尚未用于股权激励或员工持股计划)的可分配股份总数为基数, 公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整, 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年4月15日